Open Facility

(ケミカル)ドライエッチングシステム（CDE-7-4）オペレーショントレーニング開催のお知らせ

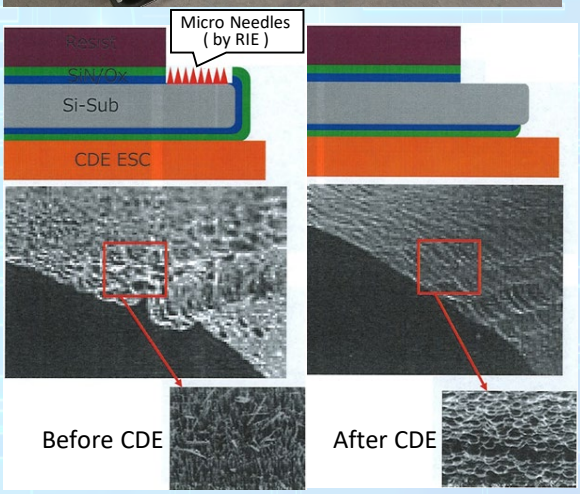
Operation Training of Dry Etching Equipment (CDE-7-4)

(Sorry, it should be noted, all presentation will be Japanese.)

筑波大学オープンファシリティー（OF）システムの登録機器、ドライエッチングシステム（CDE-7-4：芝浦メカトロニクス社）のオペレーショントレーニングを開催いたします。今回の利用講習は簡易マニュアルに沿った操作手順と取扱いの注意点を簡単に説明する短時間の講習となります。今後ご使用予定の方、装置の操作に不安をお持ちの方は是非ともお越しください。

特　　徴

- プラズマ発生部と処理（エッチング）部が完全に分離したリモートプラズマ方式であるため、プラズマダメージが入りません。
- 6インチウェハーに対応していますが、数ミリ角の小さな試料も処理することができます。
- Siの表面や溝の平滑化・ドライ洗浄、DRIE後のスキャロップ除去などが可能です。
- プラズマ電源：マイクロ波 2.45GHz 1kW
- エッチングガス：CF_4, O_2, N_2, Ar(準備中)



RIE加工後のウェハベベル剣山のクリーニング
（写真：芝浦メカトロニクス株式会社）

【日 時】8月6日（火）13:30～
【場 所】筑波大学 総合研究棟B 0022室

【内 容】
- ドライエッチングシステムの起動操作.
- サンプルセット及びエッチング操作.
- 終了手順.

締切　8月1日（木）

お問い合わせ

国立大学法人筑波大学
数理物質系　パワーエレクトロニクス共用システム（パワエレ共用）
〒305-8577　茨城県つくば市天王台１－１－１

E-mail: sharing-power-e@ml.cc.tsukuba.ac.jp

URL: http://shared-pe.bk.tsukuba.ac.jp

※ 件名に、「CDE-7-4操作講習会応募」と記載いただき、所属機関、部署（研究室名）、氏名、職名（学年）、電話番号、E-mail アドレスをご連絡ください。

※オープンファシリティーの機器利用申請がお済みではない方は、事前に申請をお願いいたします。

http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/wp/riyou1/riyou5/（学内参加者）

http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/public/regist/（学外参加者）（※学外参加者は有料となります）

Open Facility

Operation Training of (Chemical) Dry Etching Equipment (CDE-7-4)

(Sorry, it should be noted, all presentation will be Japanese.)

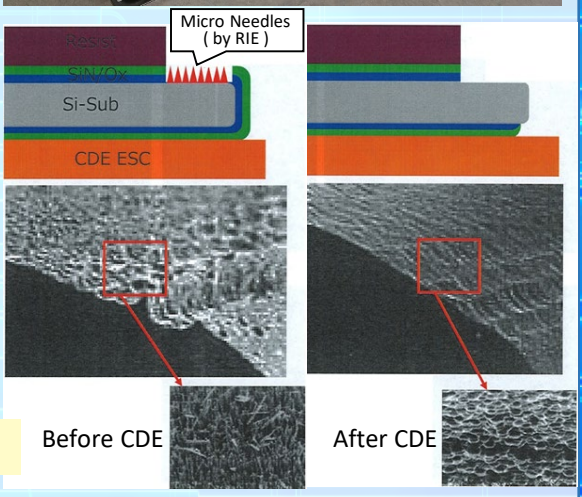
We will hold operation training of (Chemical) Dry etching equipment (CDE-7-4) which is registered in the Open Facility (OF) system of University of Tsukuba. This time, it will be a short course that briefly explains the operation procedure and the handling points. Please come by all means If you plan to use this equipment.

[Features]

- This equipment provides purely chemical dry etching applications free from plasma damage. It is possible to etch a variety of materials such as Si, SiO_2 and SiN.
- The plasma ignition point and wafer stage is isolated (complete remote plasma).

[Specification]

- Plasma power supply : Microwave 2.45GHz, 1.0kW
- Etching gas : CF_4, O_2, N_2, Ar(In preparation)
- Wafer size : A few millimeters ～ 6 inches



Wafer bevel cleaning after RIE using CDE.

(Photo by SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION)

【 Date 】 6th August (Tue.) 13:30～

【 Place 】 LABORATORY FOR ADVANCED RESEARCH B 0022 ROOM

【 Contents 】

(Sorry, it should be noted, all presentation will be Japanese.)

- Start-up procedure of the CDE equipment
- How to operate the etching process
- Ending operation of the CDE

By the deadline, 1st August

Contact Information

University of Tsukuba
Faculty of Pure and Applied Sciences
Sharing systems for power electronics equipment (Sharing-pe)
1-1-1 Tennoudai, Tsukuba City, Ibaraki, 305-8577, Japan

E-mail: sharing-power-e@ml.cc.tsukuba.ac.jp

URL: http://shared-pe.bk.tsukuba.ac.jp

The subject as “Application for Operation training of CDE-7-4”, please contact us your name, E-mail address, Faculty, laboratory name by E-mail.

※Please register this device using the Open Facility system In advance.

http://openfacility.sec.tsukuba.ac.jp/wp/riyou1/riyou5/